



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110429002A
2012 年 3 月 23 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

TI-Philippines製造 OMFCBGAパッケージ 一部製品 代替Substrate部材追加取消のご案内

(初版 PCN20110429002 2011 年 4 月 29 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更取消についての連絡になります。本変更は実施されません。詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。お客様の受領連絡は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

| | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 通知タイプ | <input type="checkbox"/> Initial notice (Plan) | <input checked="" type="checkbox"/> Final notice | | |
| 変更概要 | Design/Specification | <input type="checkbox"/> Design | <input type="checkbox"/> Electrical | <input type="checkbox"/> Mechanical |
| | Wafer Fab | <input type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | <input type="checkbox"/> Material |
| | Wafer Bump | <input type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | <input type="checkbox"/> Material |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly | <input type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | <input checked="" type="checkbox"/> Material |
| | Test | <input type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | |
| | Others | <input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling | <input type="checkbox"/> - | |
| 変更内容 | 初版連絡の下記変更内容について変更取消の連絡になります。 TI-Philippines 製造 OMFCBGA パッケージ一部製品代替 Substrate 部材追加 現行 : 認定 Substrate 変更後: 認定 Substrate, Hitachi 社製 Substrate | | | |
| 対象製品 | 対象製品リスト参照 | | | |
| 変更時期 | - | | | |
| 品質認定試験 | <input checked="" type="checkbox"/> 計画 | <input type="checkbox"/> 終了 | | |
| 製品表示 | <input checked="" type="checkbox"/> 変更無し | <input type="checkbox"/> 変更あり | | |
| 備考 | - | | | |

変更内容

内容: 今回のお知らせは、2011年4月29日発行 初版 PCN20110429002にて連絡しました下記変更について、変更取消の連絡になります。現行の部材供給業者復旧のため、本変更実施を取り消します。今後、本変更部材供給業者も含め新規部材供給業者を使用する際には、新規PCNにて、信頼性試験計画及びサンプル提供と共に別途お知らせいたします。

弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) TI-Philippines(フィリピン)サイト製造 OMFCBGAパッケージ 一部製品について、震災状況下での供給能力確保の為、代替Substrate部材追加の連絡になります。一部部材の供給制限のため、認定試験終了次第、本代替部材の追加変更は直ちに実施予定です。認定終了前のいかなる製品出荷についても、事前顧客承認が必要になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

| | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 変更内容 | 現行 | 変更後 |
| Substrate 部材 | 認定 Substrate | 認定 Substrate Hitachi 社製 Substrate |

理由: 供給能力確保の為

製品表示

この変更による製品捺印、出荷ラベルの変更はありません。部材識別については、弊社標準のロット追跡及び製造手順によりトレーサビリティは確保されます。

対象製品リスト

| 対象製品名 | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| TMS320C6202BGNY250 | TMS320C6203BZNY300 | TMS320C6413ZTSA500 | TMS320DM642AGDK6 | TMS320DM642AZNZ5 |
| TMS320C6202BGNZ250 | TMS320C6410ZTS400 | TMS320C6418ZTS600 | TMS320DM642AGDKA6 | TMS320DM642AZNZ6 |
| TMS320C6202BGNZ300 | TMS320C6412AZDK6 | TMS320C6418ZTSA500 | TMS320DM642AGNZ6 | TMS320DM642AZNZ7 |
| TMS320C6202BZNY250 | TMS320C6412AZDKA5 | TMS320DM640AZDK4 | TMS320DM642AGNZA6 | TMS320DR1300AZTSA5 |
| TMS320C6202BZNY250 | TMS320C6412AZNZ5 | TMS320DM640AZDKA4 | TMS320DM642AZDK5 | WDC320C6203BGNY173 |
| TMS320C6202BZNY300 | TMS320C6412AZNZ7 | TMS320DM640AZNZ4 | TMS320DM642AZDK6 | WDC320C6203BGNY17N |
| TMS320C6203BGNY173 | TMS320C6413GTS500 | TMS320DM641AGDK6 | TMS320DM642AZDK7 | |
| TMS320C6203BGNY300 | TMS320C6413GTS500 | TMS320DM641AZDK6 | TMS320DM642AZDKA5 | |
| TMS320C6203BGNY30C | TMS320C6413ZTS500 | TMS320DM641AZNZ6 | TMS320DM642AZDKA6 | |

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------|
| 信頼性試験期間 | 開始 | — | 終了 | 2011年9月30日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細 | | | | |
| Qualification Device: | TMS320DM642AZDK | Substrate: | Hitachi Substrate | |
| Package: | OMFCBGA | Site(s): | PHI | |
| 信頼性試験計画 | | | | |
| Reliability Test | Condition / Duration | | Sample Size | |
| Material Property Comparison | Specification Review | | per spec | |
| Preconditioning | JEDEC L-4/260C | | 539 | |
| High Temperature Storage Life | 150C, 600hrs Note(1) | | 45 | |
| Temperature Cycle | -55C/125C, 1000cyc | | 231 | |
| Temperature Humidity Bias | 85C/85%RH, 600hrs Note (1) | | 77 | |
| UnBiased HAST | 130C/85%RH, 96hrs | | 231 | |
| Note (1): Qualification Device release at 600hrs, other device Qual by Similarity/Bridge at 1000hrs | | | | |

cancel